



東京電子工業株式会社

代表取締役

こぬま かずゆき
小沼 和之 氏



「お客様の期待を超えるサービスを提供し、従業員が熱意と誇りを持って働ける環境を築きます」と話す小沼社長

難素材の高精度加工に強みを持ち、最先端製品に使われる部材の製造を手掛ける、同社の小沼社長に話を伺いました。

★貴社の概要について、教えてください。

小沼 当社は、セラミックスやガラス、ガラスとシリコンの複合材など、硬くて難しい難素材を対象に、ミクロン単位の高精度・高品質の切断および穴明け、研磨加工などを行っています。

1966年創業で、当時はダイオードのケース管の切断から始まり、電卓用ICチップの加工やラジオプレイヤーの製造、販売などを手掛けていました。1985年に液晶バックライト用ガラスの量産切断に対応するため、24時間操業の専門工場として杉戸工場（現春日部工場）を新設し、生産体制を強化しました。その後もダイシング加工技術に特化し、2004年にセミオートのマシンを導入、さらに2019年にフルオートのマシンを導入して省力化・効率化を図ってきました。

近年では、深穴加工や幅広の溝入れを求めるお

東京電子工業株式会社



所在地 戸田市笹目北町8-9

代表者 代表取締役 小沼 和之 氏

事業内容 セラミックス・ガラス・複合材の精密微細加工

資本金 3,000万円 従業員数 100名

T E L 048-422-1171

<https://tokyo-denshi.jp>



客が増えていることから、マシニングセンタを導入しました。セラミックスやガラス材をマシニング加工できる企業は少なく、当社にて、径2mm×深さ50mmの深穴加工や円形の溝入れなど、特殊形状の精密加工まで対応できます。試作から量産までお客様の多様なニーズに柔軟にお応えします。

★どのような分野に使われているのでしょうか？

小沼 半導体製造分野、IoT通信機器分野、医療機器分野、自動車分野、航空宇宙分野などの最先端製品を支える部品に使われています。

現在は、生成AI向けデータセンター関連製品の需要が増えています。世界的に生成AIが進化・大規模化し、かつてない規模の計算リソースと高速化が求められており、当社にもこれまで以上に高精度加工が要求されています。

★貴社の強みは何ですか？

小沼 これまでの経験で磨き上げてきたミクロン単位の加工技術です。硬くて難しい難素材に対し、

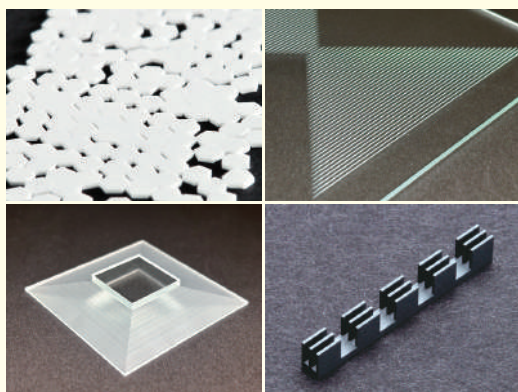
難素材を超精密に短納期加工！



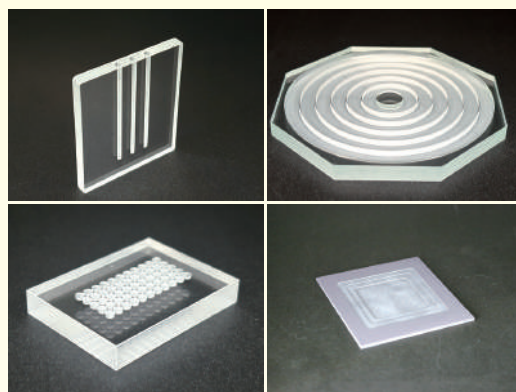
試作から量産品まで、あらゆる加工ニーズに対応



ダイシング加工で高精度、高品質を実現



切断・切削技術で難素材にもミクロン精度を実現



さまざまなニーズに応えるマシンニング加工技術

最新設備と熟練エンジニアが工程や治具を工夫し、お客様の高度な要求に応えています。納期にも柔軟に対応し、依頼当日の夜に加工して翌朝に出荷したこともあります。

品質の高さも強みの一つです。取り扱う製品はゴミやホコリに極めて敏感なため、クリーンルームで作業します。お客様からパターニングや積層済みの材料を支給していただき、当社が最終工程の切断加工を担当します。わずかなズレでも製品全体を台無しにしてしまう上に、その後の工程がほぼ自動化されており、当社の製品にバラツキがあるとその流れを止めてしまうことになるので、品質管理がとても重要になってきます。

セラミックスの場合、パターニング後に焼成を行うため、収縮によるゆがみが発生します。当社では経験に基づいて精密な測長を行うことにより、最適なラインを導き出します。他社では不良となるケースでも、良品としてカットできる点が大きな強みです。

また、刃物はダイヤモンドの含有量などにより

多種多様ですが、製品の材質や厚さに応じて最適なものを使い分け、カケやクラック（亀裂や割れ）の発生を抑制しています。外観まできれいでであると高い評価をいただいています。

★今後の展開・抱負は

小沼 今年、創業60周年を迎えます。今日まで、お客様のニーズに一つ一つ丁寧に向き合い、信頼を築いてきた先輩方や共に働く従業員たちへ、改めて感謝の気持ちを伝えたいです。そして、さらにこの先の100年を目指すに当たり、従業員にとって分かりやすい経営理念の策定を進めています。未来に向けて全員が同じ方向を向いて働ける組織を築くとともに、全員が熱意と誇りを持って働ける会社を目指します。

また、「常に新しい価値を創造していく」という決意を忘れず、正確な品質と他社にまねできない技術、優れた対応力で、お客様に喜ばれる製品やサービスを提供していけるように、これからも挑戦し続けます。

（敬称略）